

天水华天科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2011年10月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）32,900,000股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为365,848,000.00元，扣除各项发行费用15,330,000.00元后，募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2011年11月4日公司分别与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2011年11月7日，公司通过募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安公司”）增资133,000,000.00元，用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造项目”建设。

西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年11月8日与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 352,015,496.81 元，募集资金专项账户余额（含利息）为 142.82 元。募集资金存款利息累计为 1,497,639.63 元，其中：公司账户为 179,287.71 元，西安公司账户为 1,318,351.92 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，使用金额包含了公司账户收到已支付的利息 179,144.89 元，西安公司账户收到已支付的利息 1,318,351.92 元。

截至2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：（人民币）元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	截止日余额
天水华天科技股份有限公司	交通银行股份有限公司天水支行	729030110018010012838	217,518,000.00	179,287.71	217,697,144.89	142.82
华天科技（西安）有限公司	昆仑银行股份有限公司西安分行营业部	79102000048580000038	133,000,000.00	1,318,351.92	134,318,351.92	
合计			350,518,000.00	1,497,639.63	352,015,496.81	142.82

二、前次募集资金使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 352,015,496.81 元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

闲置募集资金不存在临时用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的募集资金使用计划和安排

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 142.82 元，为募集资金存款利息，将用于集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目建设。

（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

前次募集资金项目承诺投入总额 350,518,000.00 元，实际投资总额 352,015,496.81 元，实际投资总额与承诺的差额为 1,497,496.81 元，该差额为募集资金存款利息。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2，前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

公司前次募集资金用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目，各项目实现效益情况分别说明如下：

1、铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目

该项目已提前实施完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计实现效益 4,340.92 万元，其中 2012 年度项目实现效益 2,666.94 万元，为达产年预计效益的 82.06%。实际效益未达到承诺效益的主要原因是：该项目承诺效益是参照公司 2010 年产品的价格和成本并考虑预期变动进行预测，但在本项目实施期内，产品原材料成本、人工成本和动力成本均不同程度上升且增幅超出预期。

2、集成电路高端封装测试生产线技术改造项目

该项目还在建设之中，预计将于 2013 年 12 月达到预计可使用状态。截至 2012 年 12 月 31 日，项目完成投资 16,512.88 万元，占项目总投资的 55.34%。由于该项目采用边建设边生产的方式实施，设备分批采购和安装调试并投入生产，因此该项目在 2012 年度形成部分产能，并实现效益 891.47 万元。

3、集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目

该项目还在建设之中，预计将于 2013 年 10 月达到预计可使用状态。截至 2012 年 12 月 31 日，项目完成投资 25,742.90 万元，占项目总投资的 62.18%。由于该项目采用边建设边生产的方式实施，设备分批采购和安装调试并投入生产，因此该项目在 2012 年度形成部分产能，并实现效益 1,149.79 万元。

四、前次发行中以资产认购股份的资产的情况

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金的使用情况与公司已披露的信息文件中的内容一致。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天水华天科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十九日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: (人民币) 元

募集资金总额: 350,518,000.00						已累计使用募集资金总额: 352,015,496.81				
变更用途的募集资金总额: 0.00 变更用途的募集资金总额比例 (%): 0.00						各年度使用募集资金总额: 352,015,496.81 2011 年: 278,378,535.38 2012 年: 73,636,961.43				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	0.00	2012 年 12 月 31 日
2	集成电路高端封装测试生产线技术改造	集成电路高端封装测试生产线技术改造	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	1,318,351.92	55.34%
3	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,071.87	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,071.87	179,144.89	62.18%

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: (人民币) 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010 年	2011 年度	2012 年度		
1	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	98.03%	3,250.00	—	1,673.98	2,666.94	4,340.92	否
2	集成电路高端封装测试生产线技术改造	40.76%[注]	5,193.00	—	0.00	891.47	891.47	项目尚在建设中
3	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	34.09%[注]	5,463.00	—	0.00	1,149.79	1,149.79	项目尚在建设中

注: 公司的“集成电路高端封装测试生产线技术改造”和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目尚处于建设中, 产能利用率按项目截至 2012 年 12 月 31 日的实际产量与已实施产能之比进行测算。